



Messe München

Connecting Global Competence

VIP组团观众 邀请函



融合创新 智造未来



战略合作伙伴



productronica China

慕尼黑上海电子生产设备展

2020年7月3-5日 | 国家会展中心（上海）
productronicachina.com.cn



举办时间：2020年7月3-5日

举办地点：国家会展中心（上海）5.1、6.1馆

展会官网：www.productronicachina.com.cn

展商数量：近3,000家

展出面积：160,000平方米

组团参观专享礼遇

免费午餐	每位团员可获免费午餐券一份
电子胸卡	展前收到团队成员的参观电子胸卡，免去现场登记手续，直接入场参观
免费班车	江浙沪地区公司，可享免费班车接送
精美礼包	每位团员可获赠精美礼包一份（内含精美礼品、会议门票、参观指南等）
专人接待	展会现场专人接待，免费指引及讲解，拍摄参观纪念照片
商贸配对	提前告知参观、采购意向，可组织与展商深度洽谈



组团规则

- 参观者必须是来自电子行业或相关应用领域管理人员、技术研发人员或采购人员。
- 参观人数应不少于20人（江浙沪可安排班车接送）。
- 组织者需要将成员的详细名单在6月18日前提交给主办方，我们将予以审核，并于5个工作日内给予回复。

报名方式

- 第一步 扫描右侧二维码，关注慕尼黑上海电子生产设备展服务号
- 第二步 填写团长信息表单
- 第三步 下载【团体观众报名表】
- 第四步 填写后回传至：Tiffany.Liu@mm-sh.com



展品范围

- 表面贴装技术
- 测试测量和质量保证
- 产品加工
- 生产物流和物流技术
- 工业机器人
- 运动控制
- 驱动技术
- 其它生产子系统
- 焊接技术
- 点胶注胶
- 涂层设备
- 其它PCB焊接/连接技术
- 线束和连接器生产技术
- 线圈生产技术
- 混合元件制造
- 金属和非金属初加工产品和半成品
- 工艺材料
- 元器件制造
- 有机和印刷电子
- PCB及电路载体制造
- 电子制造服务

展会亮点

- 全方位展示电子制造领域先进设备和技术
- 多展联动，优质客户成就商机
- 为全行业呈现智慧电装工厂解决方案
- 高质量的组团专业观众
- 极具前瞻性的同期活动

部分展商

表面贴装技术主题展区

线束加工和连接器制造主题展区

电子制造服务展区

运动控制主题展区

电子制造自动化主题展区

焊接工具和焊料主题展区

点胶注胶主题展区

电子化工材料主题展区

* 以上排名不分先后，查看更多优秀展商，请登录productronica.china.com.cn

同期活动一览

IPC CEMAC中国电子制造年会

- 管理相关

 - 市场趋势和展望
 - 供应链管理(SCM)
 - 标准、认证和资质
- 技术相关

 - 材料和组件
 - 设计和数据传输
 - 测试和可靠性
 - PCB工艺、化学和物理
 - HDI/精细电路制造、工艺和设备
 - SMT和组装
 - 新兴/颠覆性技术
- 环境、健康和安全(EHS)

- 业务战略

- 5G应用于行业的要求

- 智能制造应用-特殊应用

电路(可穿戴，物联网，汽车，大功率，高速和能源)

- 柔性电路

- 封装/载板技术



国际柔性性与印刷电子产业论坛

- 柔性电子与印刷电子制造工艺与设备
- 印刷显示(OLED、量子点、电子纸)及其相关技术
- 印刷制备传感器技术及其应用
- 有机、柔性性与印刷电子器件的封装技术
- 印刷柔性、可拉伸、可穿戴电子技术
- PCB与RFID天线的印刷制备技术及应用



中国电子制造自动化与智能化论坛

- 从智能设备到数字化工厂
- 工业机器人助力电子制造生产自动化
- 移动机器人助力智能电子工厂
- 机器视觉和运动控制技术的集成平台
- 智能化运动控制与执行机构提升电子装配效率
- 高效检测传感器在电子制造行业的应用
- 电子工厂的智能仓储与物流系统升级
- 电子装配自动化流水线设计与产品应用



国际点胶与胶黏剂技术创新论坛

- 胶粘剂和点胶技术在电子行业的技术发展趋势和现状
- 胶水及点胶技术助力先进封装
- 胶黏剂和点胶技术在汽车电子、便携设备(智能手机，平板，可穿戴设备等)和通信行业的发展趋势、案例分享及面临的挑战
- 技术范畴：底部填充，共性覆膜，包封，导热，导电，灌封，补强，点胶技术，等离子表面处理等



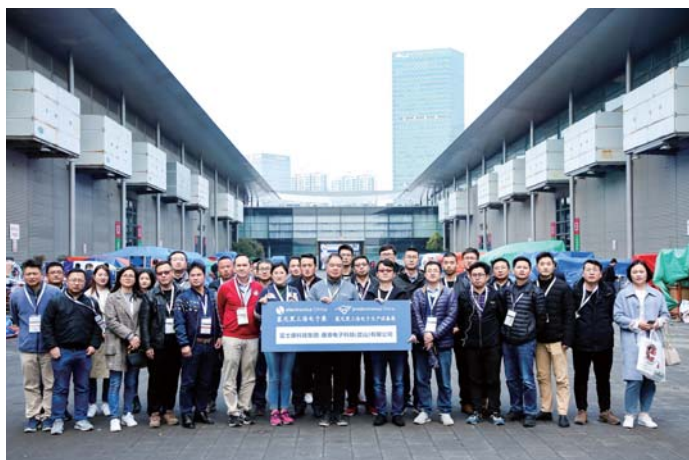
国际线束先进制造创新论坛

- 工业4.0时代线束加工的数字化工厂
- 线束生产自动化以及智能检测技术
- 线束设计及生产自动化提升
- 线束生产制造智能化升级
- 新能源汽车线束解决方案，方案评审，样品测试
- 如何实现新能源汽车线束的高压、轻量化和标准化新发展



中国国际系统级封装技术及应用论坛

- SiP技术发展趋势
- SiP技术在消费、医疗电子、智能终端等的应用
- SiP应用难点和解决方案



感谢主办方每年热情招待，连续5年组团参加慕尼黑上海电子生产设备展，每年的电子展都在不断完善进步。今年参加各种论坛，在论坛里认识了很多技术专家，也有很多志同道合的朋友，大家都是来自天南海北，难得有机会面对面的交流学习，每次收获进步不少，感谢今年的展会，也期待着明年的相聚！

吴先生，鸿腾精密科技(股)公司

这是我们第4次来参观展会，一共来了31位同事。我们主要关注工业自动化设备和标准件、工业机器人、激光、CCD光学、胶水等产品。了解了最新行业资讯，掌握未来行业的发展方向，对我司在新工艺研发方面提供有力帮助。慕尼黑主办方工作人员美丽大方，热情周到，为我们团队的参观辛苦付出，感谢你们。

任先生，美特科技（苏州）有限公司



今年我们部门昆山城南吴淞江园区组织了38人来参观学习，事业处以及各部门主管全体出动，比去年还多了12人。感谢主办方的用心安排，在展会上认识了新朋友，也看到了新设备、新技术。

王先生，康准电子科技(昆山)有限公司



更多详情，请联系组团服务专线

联系人：刘婷瑜

电话：0755-23373568

微信号：munihei520

E-mail: Tiffany.liu@mm-sh.com

